

股票简称：芯朋微

股票代码：688508

# 无锡芯朋微电子股份有限公司

Wuxi Chipown Micro-electronics limited

（无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦）



## 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二二年三月

## 发行人声明

公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

## 特别提示

1、本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2022 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次向特定对象发行尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

3、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 33,929,550 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

4、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整

的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

5、本次发行中发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日(即自本次非公开发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

6、本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	24,160.93
合计		<b>113,242.87</b>	<b>109,883.88</b>

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

7、本次向特定对象发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施和产生效益需要一定时间,期间股东回报仍然通过现有业务实现,因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长,存在每股收益、净资产收益率等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公

告》。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行 A 股股票摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

8、发行人本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。

# 目 录

发行人声明 .....	2
特别提示 .....	3
目录 .....	6
释义 .....	8
一、一般性释义.....	8
二、行业术语.....	8
<b>第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要 .....</b>	<b>10</b>
一、发行人基本情况.....	10
二、本次向特定对象发行的背景和目的.....	11
三、本次向特定对象发行股票方案概要.....	14
四、本次发行是否构成关联交易.....	17
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	17
六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.....	17
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件.....	17
<b>第二节 本次募集资金运用的可行性分析 .....</b>	<b>18</b>
一、本次募集资金使用计划.....	18
一、本次募集资金投资项目可行性分析.....	18
二、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	33
三、本次募集资金投资属于科技创新领域.....	33
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>35</b>
一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况..	35
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	36
三、本次发行完成后，上市公司与 5% 以上股东及其控制的其他企业的业务关系、 管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	36
四、本次发行完成后，是否存在 5% 以上股东及其控制的其他企业占用发行人资 金和由发行人提供担保的情况.....	36
五、本次发行对公司负债情况的影响.....	37

六、本次股票发行相关风险说明.....	37
<b>第四节 公司利润分配政策及执行情况 .....</b>	<b>40</b>
一、公司利润分配政策.....	40
二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况.....	43
三、公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 .....	44
<b>第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 .....</b>	<b>49</b>
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算.....	49
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示.....	50
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性.....	52
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.....	54
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施.....	55
六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺.....	56

# 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

## 一、一般性释义

芯朋微、公司、发行人	指	无锡芯朋微电子股份有限公司
本次发行	指	本次向特定对象发行 A 股股票
A 股	指	人民币普通股，即获准在证券交易所上市的，以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
本预案	指	无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
董事会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
股东大会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司股东大会
监事会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司监事会
公司章程	指	无锡芯朋微电子股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
英飞凌	指	Infineon Technologies AG
德州仪器	指	Texas Instruments
PI	指	Power Integrations
意法半导体 (ST)	指	意法半导体有限公司 (STMicroelectronics)
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、行业术语

集成电路 (Integrated Circuit, 简称“IC”)	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装
-----------------------------------	---	--

		在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
电源管理芯片、电源管理集成电路	指	电源管理芯片属于模拟集成电路中重要的一类，在电子设备系统中担负起对电能的交换、分配、检测及其他电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的，其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数，如电流和电压，来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号。
AC-DC	指	把交流电转成直流电，既可代指这种转变的过程，也可指能够实现这种功能的电子电路和设备。
晶圆	指	硅半导体集成电路所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
封装	指	将硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。

本预案中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。

## 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要

### 一、发行人基本情况

公司名称：无锡芯朋微电子股份有限公司

英文名称：Wuxi Chipown Micro-electronics limited

注册资本：11,309.85 万人民币

法定代表人：张立新

成立日期：2005 年 12 月 23 日

上市日期：2020 年 07 月 22 日

股票简称：芯朋微

股票代码：688508.SH

股票上市地：上海证券交易所

注册地址：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦

办公地址：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦

邮政编码：214028

联系电话：0510-85217718

公司传真：0510-85217728

公司网址：www.chipown.com.cn

电子信箱：ir@chipown.com.cn

经营范围：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；自营各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、本次向特定对象发行的背景和目的

### （一）本次向特定对象发行的背景

#### 1、国家支持力度空前，集成电路产业“十四五”面临重大机会窗口

集成电路产业是信息产业的核心之一，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。为进一步优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，国务院于2020年8月下发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面出台政策措施。同时，十三届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程，集成电路作为前沿领域之一，将成为“十四五”的国家重大科技前瞻性、战略性方向。

#### 2、应用领域蓬勃发展，集成电路产业各细分行业迎来战略机遇期

##### （1）新能源汽车行业逐步成为高成长性赛道，市场对汽车电子的需求相应大幅上升

汽车产业是我国国民经济的支柱性产业，我国是全球第一大汽车生产国和消费国。由于石油储量有限且为不可再生资源，传统燃油车不能永续发展，用新能源汽车替代燃油车已经成为全球共识。新能源汽车是实现“双碳”目标的重要抓手，对于保障国家能源安全、促进社会经济发展具有重要的战略意义。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

新能源汽车行业在政策与市场双轮驱动之下，开始逐步成为高成长性赛道。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年国内电动汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%，相对2020年提升8%，进一步说明了电动汽车产业已经从政策驱动转向市场拉动。电动汽车表现

出色、蓬勃发展，作为电动汽车电子控制系统的汽车芯片，市场对其需求相应大幅上升。

## **(2) 数据中心、5G 通信、新能源等新兴产业的兴起，为电源管理芯片带来显著的增量需求**

数据中心方面，其建设加快以及服务器的出货量持续上升，带来电源管理芯片显著的增量需求。根据 Wind 数据，2007 年至 2020 年期间，我国数据中心市场规模实现持续增长，2020 年我国数据中心市场规模达到 2,238.70 亿元，同比增长 43.28%。在服务器领域，2020 及 2021 年，我国整体服务器市场保持稳健增长，根据 IDC 数据显示，2020 年我国服务器市场出货量为 350 万台，同比增长 9.8%，其市场规模达到 216.49 亿美元，同比增长 19.0%。2021 年上半年，我国服务器市场出货量为 170.6 万台，同比增长 8.9%，其市场规模达到 108.1 亿美元，同比增长 12.1%。

5G 通信方面，2020 年我国移动通信基站数达到 931 万个，其中 5G 基站数量超过 71.8 万个。截至 2021 年 9 月，我国移动电话基站总数达 969 万个，同比增长 5.7%，其中 4G 基站总数为 586 万个，占移动基站总数的 60.4%，5G 基站总数达到 115.9 万个，占移动基站总数的 12.0%。预计到 2022 年底，我国 5G 基站将超过 200 万个，5G 的终端连接数将达到 6 亿。

新能源方面，光伏逆变器是光伏系统中的重要组件，根据 IHS Markit 数据及预测，2020 年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为 135.7GW，2021 年全球光伏逆变器市场规模将达 187GW，预计至 2025 年全球光伏逆变器市场规模有望达到 401GW，CARG 达 21.0%。

电源管理芯片及配套功率芯片被广泛的应用于数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。因此，数据中心、5G 通信、新能源等新兴产业的兴起，为电源管理芯片带来显著的增量需求。

## **(二) 本次向特定对象发行的目的**

### **1、本次发行是公司完善市场布局的重要举措**

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。本次募投项目的实施紧紧围绕公司现有主营业务、顺应公司发展战略、迎合市场需求导向、加速行业国产化替代进程，系对公司主营业务的升级和进一步拓展，是公司完善市场布局的重要举措。

### **2、本次发行将提高公司核心技术竞争力，加强项目产品线配套封测产能保障**

公司本次募集资金投资项目通过与封测厂的合作，有利于公司功率芯片设计与模块封装的技术协同创新和持续迭代优化，提高公司高密度功率封装方面的核心技术竞争力，形成智能功率器件、功率控制芯片和功率模块的组合产品技术优势，提升公司在目标市场的产品线覆盖率。此外，本次募集资金投资项目将进一步加强项目产品线配套封测产能保障，提升产品的可靠性、良率与供货能力，稳定公司的大规模交付供给。

### **3、本次发行将进一步布局公司前瞻性技术领域**

本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以高端数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含数字芯片、模拟芯片及器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。公司着眼功率半导体行业最新前沿技术领域，定位国际先进水平，为公司始终保持市场需求和技术发展的敏感性、精准选择自身战略定位作出前瞻性布局，不断巩固和提高公司在电源管理芯片领域的优势地位。

综上，本次募集资金投资项目的实施，是公司完善市场布局的重要举措；将提高公司核心技术竞争力，加强项目产品线配套封测产能保障；将进一步布局公司前瞻性技术领域，最终加强公司持续经营能力，提升对中小股东的回报。

### **三、本次向特定对象发行股票方案概要**

#### **(一) 发行的股票种类和面值**

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

#### **(二) 发行方式和时间**

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

#### **(三) 发行对象及认购方式**

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

#### **(四) 发行数量**

本次向特定对象发行股票的股票数量不超过33,929,550股,本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

### **(五) 定价基准日、发行价格及定价原则**

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），并按照“进一法”保留两位小数。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为  $P1$ 。

### **(六) 本次发行股票的限售期**

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

### **(七) 募集资金投向**

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	24,160.93
合计		<b>113,242.87</b>	<b>109,883.88</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

### **(八) 上市地点**

本次发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。

### **(九) 本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排**

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

#### **(十) 本次发行决议有效期**

本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

#### **四、本次发行是否构成关联交易**

截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次向特定对象发行 A 股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

#### **五、本次发行是否导致公司控制权发生变化**

截至本预案公告日，张立新先生直接持有公司 3,430.10 万股股份，占公司总股本的 30.33%，为公司的控股股东、实际控制人。

按照本次发行的股份数量上限 33,929,550 股测算，本次发行完成后，公司总股本将不超过 147,028,050 股，公司控股股东、实际控制人张立新先生仍将为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变更。

#### **六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序**

本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2022 年 3 月 17 日召开的公司第四次董事会第九次会议审议通过。尚需履行以下审批：

本次向特定对象发行尚待公司股东大会审议通过。

本次向特定对象发行尚待上海证券交易所审核通过。

本次向特定对象发行尚待中国证监会同意注册。

#### **七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件**

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 第二节 本次募集资金运用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	24,160.93
合计		<b>113,242.87</b>	<b>109,883.88</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

### 一、本次募集资金投资项目可行性分析

#### （一）新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目

##### 1、项目概况

在碳达峰、碳中和的政策背景下，新能源汽车行业逐步成为高成长性赛道，市场对汽车电子的需求相应大幅上升。本项目拟实施面向新能源汽车的高压电源及电驱功率芯片研发及产业化，产品主要用于新能源汽车 OBC（车载充电机）、PDU（高压配电单元）及电驱系统。本项目将开发面向 400V/800V 电池的高压电源转换分配系统、高压驱动系统的系列芯片，包括高压电源控制芯片、高压半桥驱动芯片、高压隔离驱动芯片、高压辅助源芯片以及智能 IGBT 和 SiC 器件，并

配套建设车规级半导体可靠性实验中心及封测产线。本项目拟将公司在工业电源领域积累的平台技术，升级拓展应用到新能源汽车领域，将强化公司在高压电源和高压驱动领域的技术深度和技术积累，获取更大的市场空间，为公司提供良好的投资回报和经济效益。同时，通过本项目的实施，公司将形成车规级电源及电驱芯片的相关知识产权，进一步增强公司技术实力，拓展产品领域。

## **2、项目实施的必要性**

### **(1) 本项目是紧跟国家政策、实现国产替代的重要举措**

汽车芯片出于对特殊工作环境下安全性能的考虑，具有技术标准高、测试周期长等特点。英飞凌、德州仪器等国外龙头厂商凭借先发优势垄断汽车芯片国际市场的过半份额，国内芯片设计行业起步较晚，在汽车电子领域尚处于技术攻坚的成长阶段，市占率较低。中国作为全球最大的汽车生产国和全球最大的汽车消费市场，处于产业链上游的汽车芯片仍长期依赖进口，汽车电子系统是汽车产业链的核心与基础，在中美贸易争端的时代背景下，汽车芯片的国产化是保障汽车产业长期健康发展的必然要求，汽车芯片的国产替代已上升至国家战略层面。

2020年2月24日，国家发改委等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出突破智能计算平台以及车规级芯片等关键技术。2020年9月，科技部、工信部、国创中心在京成立中国汽车芯片创新联盟，旨在建立我国汽车芯片产业创新生态，打破行业壁垒，补齐行业短板，实现我国汽车芯片产业的自主安全可控和全面快速发展。本项目布局汽车领域，完善可与国际巨头比肩的汽车电子产品线，是紧跟国家政策、实现半导体行业国产替代的重要举措。

### **(2) 布局新能源汽车领域是公司把握行业发展机遇、推动业务发展的有效措施**

新能源汽车和智能驾驶的兴起使得整车中电子电气的应用比例日益提升。汽车的电动化、网联化、智能化及共享化带来了新的应用场景与现有配置升级，功能日益强大的处理器以及逐渐增多的系统外设对电源管理提出了更高的要求，这些新增应用也是国内汽车芯片厂商最好的切入机会，将推动车规级电源及电驱功率芯片市场规模进入新的发展阶段。同时，新能源汽车相比于传统的燃油车新增

了电池、电机、电控“三电”系统，带动大量的电能转换需求，从而推动上游芯片市场显著的增量需求。

公司将以自身擅长的高压电源和高压驱动领域作为切入点，以现有车规级的技术储备为基础，扩大研发团队规模，积极探索功率芯片在汽车领域的深度应用，形成完整的功率解决方案。本项目的实施有助于公司把握新能源汽车国产替代的行业机遇，实现业务战略的继续延伸，是公司不断优化提升产品结构、进一步拓展业务规模、扩大市场份额、新增利润增长点的有效措施。

### **(3) 共建封测产线将提高公司核心技术竞争力，加强项目产品线配套封测产能保障**

汽车芯片行业技术标准要求较高，需要经过长周期的质量管理、功能安全、信息安全等标准检测与认证，才能进入产业链应用。在高端产品的后道生产工序中，通过与封测厂共建封测产线，有利于公司功率芯片设计与模块封装的技术协同创新和持续迭代优化，提高公司高密度功率封装方面的核心技术竞争力，形成智能功率器件、功率控制芯片和功率模块的组合产品技术优势，提升公司在目标市场的产品线覆盖率。

公司旨在布局汽车电子领域的高端产品，共建封测产线是在后续发展阶段巩固和加强公司自身优势的重要举措。本项目将进一步加强项目产品线配套封测产能保障，提升产品的可靠性、良率与供货能力，稳定公司的大规模交付供给。

## **3、项目建设的可行性**

### **(1) 国家相关产业发展规划为本项目提供了有力的政策支持**

在全球新一轮科技革命和产业变革下，汽车产业发展方式正发生深刻变化，新能源汽车已成为全球汽车产业转型升级的重要标志，已经成为我国大力发展的战略性新兴产业之一。

2017年4月，国家发改委、工信部、科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》指出针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。

2020年11月，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确将着力推动突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，作为实施新能源汽车基础技术提升工程的重要一环。2020年11月，工信部电子信息发布的《汽车半导体供需对接手册》提出工信部将积极引导和支持汽车半导体产业发展。同时，通过汽车半导体供需对接平台等方式加强供应链建设，加大产能调配力度，为产业平稳健康发展提供有力支撑。

国家相关政策的陆续出台为汽车半导体产业健康、快速发展营造了良好的环境。

## **（2）新能源汽车产业逐步成为高成长性赛道，本项目具备市场保障**

汽车产业是我国国民经济的支柱性产业，我国是全球第一大汽车生产国和消费国。由于石油储量有限且为不可再生资源，传统燃油车不能永续发展，用新能源汽车替代燃油车已经成为全球共识。新能源汽车是实现“双碳”目标的重要抓手，对于保障国家能源安全、促进社会经济发展具有重要的战略意义。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

新能源汽车行业在政策与市场双轮驱动之下，开始逐步成为高成长性赛道。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年国内电动汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%，相对2020年提升8%，进一步说明了电动汽车产业已经从政策驱动转向市场拉动。电动汽车表现出色、蓬勃发展，作为电动汽车电子控制系统的汽车芯片，其市场需求大幅提升，广阔的市场需求将为公司布局汽车电子领域、拓展产品应用场景提供市场保障。

## **（3）多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为本项目实施奠定基础**

公司多年来专注于电源管理功率半导体领域，积累了业内领先的高压电源和驱动类芯片可靠性设计和管控经验。2019年公司承担并顺利完成“超快动态响

应自供电高压电源管理电路系列产品研发及产业化”等 6 项省级重大科研项目，在高压电源和驱动电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。同时，公司向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，在高压电源和驱动芯片领域具有国内领先的研发实力。公司在国内创先开发成功并量产了单片 700V 高低压集成开关电源芯片、1200V 高低压集成开关电源芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片等产品，均获得国家/省部级科技奖励和国家重点新产品认定。多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为公司拓展下游领域、布局汽车赛道打下了坚实的基础。

#### (4) 公司强大的研发团队为本项目顺利实施提供了坚实基础

公司自成立以来专注于以电源管理为主的模拟及数模混合集成电路设计，尤其在高低压集成半导体技术领域具有较强的行业领先优势。公司以核心技术创新研发为企业基因，旨在为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的集成电路产品与全面一站式的应用解决方案。公司深耕电源管理芯片十余年，现有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心等人才培育中心，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 215 人，占总员工数量的比例为 75.44%，其中拥有研究生学历的研发人员占总研发人员数量的比例为 32.56%，公司核心技术人员均拥有多年丰富的集成电路设计研发经验和深厚的技术背景。同时，公司拥有 84 项已授权的国内外专利、100 项集成电路布图专有权。

公司经验丰富的研发团队及技术储备为项目实施提供了支持。

#### 4、投资概算

本项目预计建设期为 4 年，项目总投资 39,779.57 万元，拟投入募集资金 38,428.29 万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	金额	单位
1	项目总投资	39,779.57	万元
2	场地购置、装修费用	1,725.00	万元
3	软硬件设备及 IP 购置	24,921.63	万元
4	研发费用	11,781.66	万元

5	基本预备费	768.56	万元
6	铺底流动资金	582.72	万元

## 5、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司，项目选址定于江苏省无锡市。

## 6、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

## (二) 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目

### 1、项目概况

本项目拟面向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景，实施工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发、测试及产业化，主要开发产品包括大功率数字电源控制芯片、集成桥式驱动和智能采样的高频开关模块、高频 GaN 驱动芯片、智能 GaN 器件及 GaN 模块，并配套建设工业级半导体测试中心。

本项目将通过数字电源管理芯片产品的技术研发与产业化应用，提升公司数字电源管理芯片的性能指标并拓展产品品类，抢占工业场景的市场先机，提升市场覆盖范围，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

### 2、项目实施的必要性

#### (1) 本项目有助于公司切入新兴市场，打破国外企业在高端应用领域的垄断地位

由于我国芯片产业发展较晚，加之数字电源管理芯片具有较高的技术壁垒，国内电源管理芯片厂商目前基本采用技术简单、成本较低的模拟类解决方案，应用于消费电子领域及初级工业控制领域。伴随着消费电子类芯片产品赛道逐渐饱和、竞争日趋激烈，积极布局大型服务器与数据中心、基站、光伏逆变器、储能等中高端产品应用领域成为公司巩固和提高在主营产品赛道竞争优势的重要战略选择。

大功率数字电源芯片需要将与真实电源环境相连的模拟环路及数字算法管理相结合，要求技术人员同时掌握数字编程技术，以及电源模拟的环路和需求，具有较高技术壁垒。国内电源管理芯片设计厂商的 IP 设计技术、工艺集成度等，与英飞凌、德州仪器等国外电源管理龙头厂商相比还有差距，下游大功率应用领域供货长期主要依赖进口。本项目通过数字电源管理芯片产品的技术研发与产业化应用，不断提升公司数字电源管理芯片的性能指标并拓展产品品类，逐步填补国内电源管理领域数字化解决方案的空白，对实现中高端应用领域所需数字电源管理芯片产品的国产替代具有重要的战略意义。

### **(2) 本项目是公司抢占大功率市场份额，形成新的利润增长点的重要举措**

近年来，随着数据中心、5G 通信、新能源等新兴产业的兴起，数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等领域的大规模应用，为电源管理芯片带来显著的增量需求。数字电源管理芯片凭借着更高的灵活性、可扩展性和重复使用性等特点，能够更好满足上述应用场景对于电源效率、集成度以及整体性能的高要求。同时，工业电源管理芯片市场属于高毛利率的新兴成长市场，进口替代空间较大，技术门槛较高。

结合对上述产业的前瞻性深度研究，为全面满足客户的多样化产品需求，公司将依托现有技术平台以及丰富的工业级产品开发经验，在现有产品线基础上不断推陈出新。本项目布局的数字电源管理芯片及配套功率芯片将满足工业市场对于大功率电源管理芯片的市场需求。本项目的实施是公司把握行业发展机遇的重要举措，有利于公司抢占工业场景的市场先机，提升市场覆盖范围，在未来形成新的利润增长点。

### **(3) 本项目是公司进行战略布局的重要决定**

集成电路设计行业属于技术密集型行业，是集成电路产业链中创新成果高度集中的重要环节，研发实力在很大程度上决定了公司能否在激烈的市场竞争中取胜。集成电路设计领域产品迭代周期较短，下游终端市场日新月异，如果研发进度滞后，企业将在长期竞争中处于被动地位。相比于国外行业龙头企业，公司在产品丰富度、应用领域方面尚有差距，公司现阶段产品线有待通过持续的新产品研发实现拓展，形成种类更全面、应用更广泛的产品体系。

公司始终坚持根据行业发展方向进行持续创新，提前进行技术研发升级和产品布局。本项目的实施不仅有助于提升公司在电源管理领域的市场份额，还推动公司产品应用领域向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等工业场景跨越。本项目实施后，公司将扩建研发团队，并给予技术研发充分的资金支持，形成工业级电源管理芯片相关知识产权，进一步提升公司的技术研发水平，拓展产品领域。公司也将通过提供自主可控的高可靠性、高性能电源管理解决方案，持续为客户创造价值，巩固行业地位。

### **3、项目建设的可行性**

#### **(1) 国家出台多项政策驱动集成电路产业发展，为本项目提供政策保障**

集成电路是各领域信息化、数字化转型建设的基础和核心，是新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，我国有关部门相继出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知》等多项产业扶持政策，从财税、投融资、研究开发、人才培养、国际合作等多个方面促进我国集成电路产业发展。2021年3月，全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调在“十四五”期间要进一步强化国家战略科技力量，加强集成电路等基础性核心技术攻关，推动集成电路产业创新发展，进一步为集成电路行业的参与者提供了良好的发展环境。

电源管理芯片作为消费电子、工业、通讯、汽车等产品不可或缺的上游集成电路元件，而数字电源管理芯片以更加优异的性能在现代产业体系构建中的重要地位日益显著。我国集成电路产业政策呈现出的延续性为本项目建设提供了良好的发展环境及政策保障，项目实施具备可行性。

#### **(2) 公司深耕于电源管理芯片领域，拥有强大的人才和技术储备**

公司成立16年以来，始终专注于电源管理芯片领域，持续增加研发投入，形成了良好的技术和人才积累，实现功率集成电路的工艺、器件、电路、封装和测试的全产业链创新。在人才方面，公司拥有由多名专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的技术人员组成的研发团队，截至2021年12月31日，公

司研发人员数量 215 人，占公司总人员 75.44%，核心技术团队中包含 3 名博士学位人员与 67 名硕士学历人员。研发经验丰富、长期稳定、配合默契的技术团队为公司的研发工作提供了坚实的保障。

公司拥有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心，具备完善成熟的培训体系，对员工提供实践性的内部传帮带式职能培训与外派进修式的专业培训。此外，公司经常举办技术讲座以加深员工之间技术交流。完善的培训和培养体系为公司技术人才团队建设提供了支撑。

在技术方面，公司拥有 84 项已授权的国内外专利，100 项集成电路布图登记，15 项原始创新的核心技术，其中 5 项属国际先进水平，分别为智能功率器件高低压集成工艺技术、超低功耗高压启动技术、200V-1200V 螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术、40V-1200V SmartMOS 器件过流保护技术以及 600V 高压隔离浮置栅半桥驱动技术。本项目将基于电源管理芯片技术基础向工业级数字电源芯片领域研发拓展，多年积累的专业技术、人才及管理经验为本项目建设提供了良好依托，项目实施具备可行性。

### **(3) 成功的工业级产品开发经验与开发管理流程为本项目实施提供良好的经验借鉴**

公司自成立以来专注电源芯片领域。2013 年，基于第三代“高低压集成技术平台”，公司正式切入工业驱动芯片市场，并于 2014 年在国内创先量产了内置 1000~1200V 智能 MOS 的超高压 AC-DC 电源芯片，成功进入国网/南网的智能电表和智能断路器市场，率先实现了电表中高压电源芯片的进口替代，产品线进一步丰富，业务规模快速增长。2016 年，公司配合行业高端客户的电源开发需求，基于第四代智能 MOS 数字式多片高低压集成平台，开发了全新一代数字化内核的多模式电源管理芯片，陆续推出全模式高功率集成原边反馈开关电源芯片、零瓦待机 800V 工业开关电源芯片和 1000V 工业级 X-cap 放电电源芯片等新品。2019 年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。

2021 年公司工控功率类芯片产品收入 11,775.51 万元，较 2020 年增长 122.83%，占主营业务收入的比例达到 15.75%，工业级产品规模及收入占比持续增长。公司工业驱动类芯片的主打系列包括 800V 智能保护 AC-DC 电源芯片系列、1000~1200V 工业 AC-DC 电源芯片系列、零瓦待机 AC-DC 工业电源芯片系列、600V 浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

成功的工业级产品开发经验与开发管理流程为本项目实施提供良好的经验借鉴。

#### **(4) 广阔的工业市场为募投项目的实施提供了基础**

本项目所涉及的电源管理芯片及配套功率芯片被广泛的应用于数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。

数据中心方面，其建设加快以及服务器的出货量持续上升，带来电源管理芯片显著的增量需求。根据 Wind 数据，2007 年至 2020 年期间，我国数据中心市场规模实现持续增长，2020 年我国数据中心市场规模达到 2,238.70 亿元，同比增长 43.28%。在服务器领域，2020 及 2021 年，我国整体服务器市场保持稳健增长，根据 IDC 数据显示，2020 年我国服务器市场出货量为 350 万台，同比增长 9.8%，其市场规模达到 216.49 亿美元，同比增长 19.0%。2021 年上半年，我国服务器市场出货量为 170.6 万台，同比增长 8.9%，其市场规模达到 108.1 亿美元，同比增长 12.1%。

5G 通信方面，2020 年我国移动通信基站数达到 931 万个，其中 5G 基站数量超过 71.8 万个。截至 2021 年 9 月，我国移动电话基站总数达 969 万个，同比增长 5.7%，其中 4G 基站总数为 586 万个，占移动基站总数的 60.4%，5G 基站总数达到 115.9 万个，占移动基站总数的 12.0%。预计到 2022 年底，我国 5G 基站将超过 200 万个，5G 的终端连接数将达到 6 亿。

新能源方面，光伏逆变器是光伏系统中的重要组件，根据 IHS Markit 数据及预测，2020 年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为 135.7GW，2021 年全球光伏逆变器市场规模将达 187GW，预计至 2025 年全球光伏逆变器市场规模有望达到 401GW，CARG 达 21.0%。

由此，广阔的下游应用领域保障了对公司产品的充足需求，为公司发展提供了巨大的市场空间。

#### 4、投资概算

本项目预计建设期为 4 年，项目总投资 48,819.15 万元，拟投入募集资金 47,294.66 万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	48,819.15	万元
2	场地购置、装修费用	1,900.00	万元
3	软硬件设备及 IP 购置	33,928.00	万元
4	研发费用	11,466.66	万元
5	基本预备费	945.89	万元
6	铺底流动资金	578.60	万元

#### 5、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司，项目选址定于江苏省无锡市。

#### 6、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

### （三）苏州研发中心项目

#### 1、项目概况

电源管理芯片作为先进设备的核心，下游市场对其技术和性能的要求不断提升。本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含芯片和器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。公司着眼功率半导体行业最新前沿技术领域，定位国际先进水平，为公司始终保持市场需求和技术发展的敏感性、精准选择自身战略定位作出前瞻性布局，不断巩固和提高公司在电源管理芯片领域的优势地位。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 本项目是公司拓展下游目标市场和丰富产品线的必然要求

随着新能源汽车等下游应用领域的技术迭代，以及终端产品种类和功能的不断丰富，电源管理芯片的应用场景愈发广泛，同时也增加了对电源管理芯片协调设备内部各模块供电的难度及复杂程度。

新能源汽车领域方面，新能源汽车和智能驾驶的兴起使得整车中电子电气的应用比例日益提升，汽车的电动化、网联化、智能化及共享化带来了新的应用场景与现有配置升级，功能日益强大的处理器以及逐渐增多的系统外设对电源管理提出了更高的要求，这些新增应用也是国内汽车芯片厂商最好的切入机会，将推动车规级电源及电驱功率芯片市场规模进入新的发展阶段。同时，不断崛起的新能源汽车相比于传统的燃油车新增了电池、电机、电控“三电”系统，带动大量的电能转换需求，从而推动上游芯片市场显著的增量需求。

工业领域方面，能耗主要来自于电机和数据中心。其中电机包括泵、风机、压缩机、传输机等，电机消耗的能量几乎占工业电力消耗的 80%。工业领域对节能的要求，促使电源芯片不断提高转换效率。比如使用变速电机能节省 40% 的能耗，使用高效的开关电源可以节省 35% 的能耗，这均是由更先进的电源芯片支撑。随着数据中心的人工智能处理器的推出，供电功率上限不断提升，对电源管理芯片的集成度和效率提出更高的要求。为了满足下游市场多样化的需求，企业需持续增加研发投入以保持竞争优势。

本项目建设通过引进更多的前沿技术人才、购置相应的先进实验设备，坚持专注公司主营业务方向—电源芯片的前沿技术研发，有助于稳固公司自身的技术“护城河”，始终为市场提供最具竞争力的电源芯片产品，从而提升公司在电源芯片领域的市场地位，项目实施具有必要性。

### (2) 本项目的实施有助于增加公司高端人才储备

集成电路行业是全球信息产业的基础，在产业资本的驱动下，已经逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力和经济表现的重要标志。其广泛应用于人们的生活当中，推动了电子时代的发展。集成电路行业属于技术密集型高新技术产业，

对于芯片设计行业，人才是技术研发的核心，企业需要不断引进和培养优秀的行业人才以维持产品的科技能力。因此，人才团队的建设和稳定将对公司产品线的突破和创新起到推动作用。

人才紧缺是制约高新技术产业发展的最大痛点之一，为了满足更新迭代周期快的下游市场，公司拟加大研发投入，构建高精尖的人才团队，一方面开展模拟电源管理芯片的更新迭代，另一方面进行数字电源管理芯片的研发，进一步推动对芯片设计行业人才的需求。

本项目将把人才环境建设作为发展战略目标，提供完善的研发环境和管理体系，研究和制定多种灵活的人才引进和培养政策，为公司的研发开展和项目建设提供有效支撑。

### **(3) 本项目建设有助于产业减少对国外技术的依赖**

电源管理芯片是电子设备重要的组成部分，为设备的运行输入源源不断的动力，应用领域广泛，如工业领域、家电领域、通讯领域等皆需要电源的使用。目前，中国大陆电源管理芯片设计企业处于上升期，在中小功率相关产品已经实现部分国产化，但大部分电源管理芯片的供应来自于进口，国产厂商发展方兴未艾。因此，企业需要增强技术能力和储备，增加自有知识产权对产品进行拓展研发和升级以满足下游产业的大功率发展趋势。

电源管理芯片行业具有研发周期长、技术难度高等特点，持续的研发投入将为企业带来巨大的竞争优势，公司在电源管理行业深耕 16 年，积累了大量的行业经验，其中不乏国际先进水平的核心技术。基于现有技术的基础上进行研发有利于公司突破更多技术瓶颈，实现更多产品的国产替代。项目的实施是对公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固公司的竞争地位。

此外，随着公司的不断发展壮大以及技术开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，充分保障技术研发的顺利进行。本项目建设是提升公司整体研发水平，增加自主知识产权，助力我国电源管理芯片行业实现国产替代的重要举措。

### 3、项目建设的可行性

#### (1) 国家政策的有力支持为本项目实施提供了良好的政策环境

集成电路产业是信息技术产业的核心，电源管理芯片是通电类产品的电能供应中枢和纽带，负责所需电能的变换、分配、检测和控制等功能。实现电源管理领域高端产品细分赛道的国产化，对提升我国在国际芯片舞台上的竞争力具有重大的战略意义。

为了增强我国集成电路的竞争力和自主化，我国政府相继出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等多项鼓励性政策，从财税、技术、人才、应用、国际合作等多方面予以优惠，持续促进我国集成电路产业发展。

2021年3月，全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步明确了集成电路领域技术攻关和创新在“十四五”期间的重要地位。我国集成电路产业的政策红利显示出了良好的延续性，有利于推动我国电源管理芯片行业的健康发展，为本项目顺利实施提供了可靠的政策保障。

#### (2) 公司核心技术积累为本项目研发目标的顺利实现提供了技术基础

公司是一家专业从事功率集成电路及其解决方案的定义、设计、研发的高新技术企业，在多年的电源管理芯片技术和产品开发实践中，公司取得了丰富的技术及经验积累。截至2021年12月31日，公司累计取得国内外专利84项，其中发明专利65项，另有集成电路布图设计专有权100项。

目前，公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字/模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了4代核心技术平台。此外，公司拥有经验丰富的研发团队，公司核心团队均具有十年以上集成电路行业研发经验，拥有较强的研发实力。自

公司成立以来，公司核心团队保持稳定。丰富的技术积累及研发创新能力、优秀的技术研发团队是募投项目顺利实施的重要支撑。

### **(3) 募投项目所在地具备长三角集成电路企业集群优势**

我国集成电路主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。本项目所在地苏州地处长三角，其集成电路产业已形成以“芯片设计-晶圆制造-封装测试”为核心，以设备、原材料及服务产业为支撑的集成电路产业链，是国内产业链较完整的区域之一，有利于公司研发项目的顺利开展以及对产业化项目提供技术支持。

首先，长三角区域半导体企业集聚度高。芯片生产的流程包括芯片设计、生产、封测等步骤，而生产又涉及到原材料采购、加工和清洗等步骤，产业集聚效应减少了产品的运输风险，且提高了生产效率。其次，产业集群更有利于吸引业内人才和培养人才。公司所在的集成电路行业属于技术密集行业，人才梯队建设是企业长期健康发展的基础，由于长三角地区产业链完整，具有人才聚集效应，能够为公司未来的技术研发项目提供更好地支撑。

本项目拟建地址为江苏省苏州市，该地区是国内领先的高新技术成果转化孵化基地，汇聚了多家大中型企业，商业氛围浓厚，为公司吸引高素质的专业人员和多元化人才提供了便利条件。

同时，公司拟在公司现有办公地点附近新购置 5,000 平方米办公区域用于研发中心办公场地。苏州市地理位置优越，交通便利，各种配套设施齐全，房产交易较为活跃，公司较易取得合适的房产，项目具备可行性。

## **4、投资概算**

本项目预计建设期为 4 年，项目总投资 24,644.15 万元，拟投入募集资金 24,160.93 万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	24,644.15	万元
2	场地购置、装修费用	10,350.00	万元

3	软硬件设备及 IP 购置	4,371.15	万元
4	研发费用	9,439.78	万元
5	基本预备费	483.22	万元

## 5、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司的全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司，项目选址定于江苏省苏州市。

## 6、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

## 二、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

## 三、本次募集资金投资属于科技创新领域

### （一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司为集成电路设计企业，主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发电源管理集成电路，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、

品质稳定的电源管理集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。目前公司已开发出 1200 多个型号的产品。公司主营业务属于科技创新领域。

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，旨在完善市场布局、提高公司核心技术竞争力、加强项目产品线配套封测产能保障，并新建苏州研发中心以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

## **（二）募投项目促进公司科技创新水平提升**

公司重视自身产品技术和性能的不断升级，进一步突出公司电源管理芯片设计方面积累的丰富经验、优秀的人才和研发储备的优势，并为此制定中期战略发展规划。

本次募投项目包括新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。通过本次募投项目的实施，公司将发挥自身研发创新优势，加速提升公司在电源管理芯片设计领域的技术水平和产业化能力，从而推动电源管理芯片产品的国产化，保障产业链安全，加快国产替代、自主可控进程，同时新建苏州研发中心以利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究，持续提升公司的科技创新实力。

## **第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

### **一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况**

#### **(一) 本次发行对公司业务的影响**

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。本次募投项目的实施紧紧围绕公司现有主营业务、顺应公司发展战略、迎合市场需求导向、加速行业国产化替代进程，系对公司主营业务的升级和进一步拓展，是公司完善产业布局的重要举措。公司通过本次募投项目的实施，将进一步提升市场竞争力扩大生产经营规模，提升公司盈利能力。

#### **(二) 本次发行对《公司章程》的影响**

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将发生变化。届时，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中相关的条款进行修改，并及时办理工商变更登记。

#### **(三) 本次发行对股东结构的影响**

截至本预案公告日，张立新先生直接持有公司 3,430.10 万股股份，占公司总股本的 30.33%，为公司的实际控制人。

按照本次发行的股份数量上限 33,929,550 股测算，本次发行完成后，公司总股本将不超过 147,028,050 股，发行人控股股东、实际控制人张立新先生仍将为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变更。

#### **(四) 本次发行对高级管理人员结构的影响**

本次发行完成后，公司高级管理人员结构不会因此发生重大变化。

## **二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

### **（一）财务状况变动情况**

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均会有所增加，公司资产负债率将会有所下降，有利于提高公司抗风险能力；公司流动比率和速动比率将进一步提高，有利于提高公司偿债能力。公司的财务结构将进一步改善，资本实力将得到增强，为公司后续业务开展开拓提供良好的资金保障。

### **（二）对盈利能力的影响**

本次发行募集资金到位后，公司整体业务和资金实力将得到进一步增强，但鉴于募投项目从建设到实现收益需要一定周期，在短期内公司每股收益可能将被摊薄，净资产收益率可能有所下降。从中长期来看，随着本次募集资金到位以及本次募投项目的顺利落地实施，公司主营业务将被进一步强化、资本结构将得到一定的优化、核心竞争力将得到增强，有利于公司扩大营收、提升盈利能力，为公司未来的发展打下坚实基础。

### **（三）对现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金净流入量将有所增加，筹资能力进一步增强，并有利于公司增加业务拓展能力，提升公司未来经营现金净流量，从而增强公司持续回报能力，实现公司股东利益的最大化。

## **三、本次发行完成后，上市公司与 5%以上股东及其控制的其他企业的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行完成后，公司与 5%以上股东及其控制的其他企业之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生较大变化。

## **四、本次发行完成后，是否存在 5%以上股东及其控制的其他企业占用发行人资金和由发行人提供担保的情况**

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被 5%以上股东及其控制的其他企业占用的情况，也不存在 5%以上股东及其控制的其他企业由发行人提供担保

的情况。公司也不会因本次发行而产生 5%以上股东及其控制的其他企业占用公司资金和由公司提供担保的情况。

## **五、本次发行对公司负债情况的影响**

本次发行完成后，公司资本规模大幅增加，营运资金得到进一步充实，不存在因本次发行大幅增加负债的情形。在本次募集资金到位后，公司财务结构将进一步优化，抵御风险能力将进一步增强，符合公司全体股东的利益。

## **六、本次股票发行相关风险说明**

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

### **（一）本次向特定对象发行 A 股的相关风险**

#### **1、审批风险**

本次发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会批准本次发行、上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册等。本次发行能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

#### **2、发行风险**

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。

本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。

因此，本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

#### **3、即期回报被摊薄的风险**

本次向特定对象发行股票募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务

指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

## **（二）市场和经营风险**

### **1、市场竞争加剧的风险**

从整体市场份额来看，目前国内电源管理芯片市场的主要参与者仍为欧美企业，占据了 80%以上的市场份额，因此国内企业目前尚无法与德州仪器（TI）、PI、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST）等企业在产销规模上竞争。同时，国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量众多，市场竞争日趋激烈。公司产品市场占有率较低，在技术实力、市场份额方面和境外竞争对手相比均存在差距，面临较大的国内外品牌的竞争风险。若竞争对手利用其品牌、技术、资金优势，加大在公司所处市场领域的投入，可能对公司市场份额和销售额形成挤压，从而影响公司的盈利能力。

### **2、客户认证失败的风险**

公司芯片产品需要通过客户测试认证才能进入批量供应阶段。因下游产品存在更新迭代，不论新老客户，每年都会有多款新产品需要进行客户认证，若客户测试认证失败，存在客户选择其他公司产品进行测试认证的可能，从而导致该款芯片不能在客户该款产品中形成销售。若公司连续多款产品在同一客户中认证失败，有可能导致客户对公司产品品质产生质疑，从而导致公司不能获得新客户或丢失原有客户，导致公司收入和市场份额下降，进行对公司盈利能力产生不利影响。

### **3、产品质量的风险**

公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对较高，但同时也对公司研发、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。随着行业内对产品不良率要求的提高，若在上述环节中发生无法预料的风险，可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

#### **4、供应商集中度较高的风险**

2021 年度公司前五大供应商的采购占比为 81.41%，公司供应商集中度较高。如果上述供应商产能紧张、提价或由于某种原因停止向公司供货，将导致公司短期内产品供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

#### **（三）募投项目风险**

公司募集资金项目的可行性研究是基于当前经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为本次募集投资项目预期经济效益良好。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等存在不确定性，以及项目实施风险（成本增加、进度延迟、募集资金不能及时到位等）和人员工资可能上升等因素，有可能导致募集资金投资项目的实际效益不及预期。

## 第四节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司利润分配政策

#### （一）利润分配原则

公司利润分配政策的基本原则为：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）利润分配形式

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

#### （三）利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

#### （四）利润分配的条件和比例

1、现金分配的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来

十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

2、实施股票分红的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## **（五）利润分配的决策机制与程序**

1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。

3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## （六）利润分配政策调整

公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：①因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；④公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司调整现金分红政策的具体条件：

（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

（2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

(3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

(4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

### **(七) 利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

### **(八) 其他事项**

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

## **二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况**

### **(一) 现金股利分配情况**

公司于2020年7月完成首次公开发行股票，截至目前，公司上市未满三年，上市后公司现金股利分配具体情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2020 年度	3,384.00	9,973.62	33.93%
2021 年度	6,785.91	20,128.09	33.71%

2020 年度，根据 2021 年 4 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会决议，以公司总股本 11,280.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 3,384.00 万元（含税）。

2021 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。若以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 113,098,500 股为基数测算，预计派发现金红利总额为 67,859,100 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 33.71%。该利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

公司于 2020 年 7 月 22 日上市，上市后现金分红情况符合公司章程及股东回报规划的要求。

## （二）未分配利润使用情况

最近三年，公司实现的归属于公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的主营业务发展。

## 三、公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划

为健全无锡芯朋微电子股份有限公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等文件要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《无锡芯朋微电子股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

## **（一）公司制定本规划主要考虑的因素**

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

## **（二）本规划的制定原则**

在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、监事的意见，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

## **（三）公司未来三年（2022年-2024年）的具体股东回报规划**

### **1、利润分配形式**

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

### **2、利润分配的期间间隔**

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

### **3、利润分配的条件和比例**

（1）现金分配的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未

来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

(2) 实施股票分红的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(3) 现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### **4、利润分配的决策机制与程序**

(1) 董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。

(3) 董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

(4) 股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## 5、利润分配政策调整

(1) 公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

1) 因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

2) 因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

3) 出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；

5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 公司调整现金分红政策的具体条件：

1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2) 自利润分配的股东大会召开日后的两个月内, 公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等) 余额均不足以支付现金股利;

3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;

4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

## **6、利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况, 说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的, 公司应当在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见, 同时在召开股东大会时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

## 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：

### 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算

#### （一）测算假设及前提

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次发行于 2022 年 9 月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

4、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 33,929,550 股，募集资金总额不超过 109,883.88 万元。因此，假设本次发行数量为 33,929,550 股，发行后公司总股本为 147,028,050 股，募集资金总额为 109,883.88 万元，未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司披露的 2021 年年度报告，2021 年度归属于母公司股东的净利润为 20,128.09 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,192.19 万元。假设 2022 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2021 年度增长 10%、增长 20%和增长 30% 三种情况测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测；

6、在预测本次发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，并假设 2022 年度权益分配金额与经第四次董事会第九次会议审议通过的《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》金额相等；

7、假设 2022 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2022 年期初归属母公司所有者权益+2022 年归属于普通股股东的净利润-2021 年度现金分红额+本次向特定对象发行募集资金总额；

8、在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本 113,098,500 股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；

9、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
<b>假设 1：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 10%</b>			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73

归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	22,140.90	22,140.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	16,711.40	16,711.40
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	-	-	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	166,822.72	276,706.60
基本每股收益（元/股）	1.7844	1.9577	1.8211
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.4776	1.3745
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	1.9528	1.8169
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.4739	1.3713
加权平均净资产收益率	14.45%	13.69%	11.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	10.33%	8.83%
<b>假设 2：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 20%</b>			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	24,153.71	24,153.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	18,230.62	18,230.62
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	-	-	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	168,835.53	278,719.40
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.1356	1.9866
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.6119	1.4995
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.1304	1.9821
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.6079	1.4960
加权平均净资产收益率	14.45%	14.84%	12.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	11.20%	9.58%
<b>假设 3：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 30%</b>			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73

归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	26,166.52	26,166.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	19,749.84	19,749.84
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	-	-	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	170,848.34	280,732.21
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.3136	2.1522
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.7463	1.6244
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.3079	2.1472
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.7419	1.6207
加权平均净资产收益率	14.45%	15.98%	13.68%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	12.06%	10.33%

## 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行股票募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

同时，在相关法律法规下，公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中对 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施，并不构成公司的盈利预测，填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

## 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

### （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求

为把握行业发展契机，丰富公司产品结构，进一步拓展公司主营业务，提升公司的盈利能力，公司拟通过本次发行募集资金用于新能源汽车高压电源及电驱

功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目，和苏州研发中心项目。

通过实施新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目，有利于公司进一步拓展公司电源管理芯片的业务范围，扩展公司电源管理芯片业务的产品结构，提升公司在电源管理芯片设计领域的竞争力；同时公司将建设苏州研发中心项目，以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。

前述募集资金投资项目所需资金规模较大，若全部由公司自有资金和债权融资投入，公司将面临较大的资金压力和偿债压力。故公司通过本次向特定对象发行股票募集资金，能够有效解决上述项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

## **（二）符合公司经营发展规划**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用符合公司战略发展方向。募集资金到位后，有助于提高公司的资本实力，增强公司的风险防范能力，提高公司的综合竞争力，提升公司在行业内的地位为公司带来新的业绩增长点。因此，本次向特定对象发行 A 股股票对公司经营发展有着积极的意义，有利于公司长期稳定的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

## **（三）向特定对象发行股票是公司现阶段最佳的融资方式**

与股权融资相比，通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会导致公司整体资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，另一方面会产生较高的利息费用，挤压降低公司整体的利润空间，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定。

综上，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金具有必要性。

## **四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

### **（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，旨在完善市场布局、提高公司核心技术竞争力、加强项目产品线配套封测产能保障，并新建苏州研发中心以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

### **（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

#### **1、人员储备**

公司通过自主培养为主、外部引进为辅的方式培养了一支具有竞争力的技术研发团队。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有研发人数 215 人，占总员工数量的比例为 75.44%，其中拥有研究生学历的研发人员占总研发人员数量的比例为 32.56%，公司核心技术人员均拥有多年丰富的集成电路设计研发经验和深厚的技术背景。

#### **2、技术储备**

目前，公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字/模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了 4 代核心技术平台。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 84 项已授权的国内和国际专利，100 项集成电路布图登记，15 项原始创新的核心技术，其中 5 项属国际先进水平，分别为智能功率器件高低压集成工艺技术、超低功耗高压启动技术、200V-1200V 螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术、40V-1200V SmartMOS 器件过流保护技术以及 600V 高压隔离浮置栅半桥驱动技术。

### 3、市场储备

公司多年来专注于高压电源管理及控制领域，积累了业内领先的高压电源和驱动类芯片可靠性设计和管控经验。公司向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，在高压电源和驱动芯片领域具有国内领先的研发实力。公司在国内创先开发成功并量产了单片 700V 高低压集成开关电源芯片、1200V 高低压集成开关电源芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片等产品，均获得国家/省部级科技奖励和国家重点新产品认定。多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为公司拓展下游领域、布局汽车赛道打下了坚实的基础。

从工业级产品开发经验来看，2019 年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。公司工业驱动类芯片的主打系列包括 800V 智能保护 AC-DC 电源芯片系列、1000~1200V 工业 AC-DC 电源芯片系列、零瓦待机 AC-DC 工业电源芯片系列、600V 浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

## 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，增强公司的可持续发展能力，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

### （一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度。公司将根据相关法律法规和募集资金管理制度的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

## **（二）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力**

本次发行募集资金将主要投入新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，上述募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

## **（三）完善公司治理，为企业发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

## **（四）完善利润分配政策，重视投资者回报**

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

## **六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

### **（一）公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺**

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## **(二) 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺**

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日